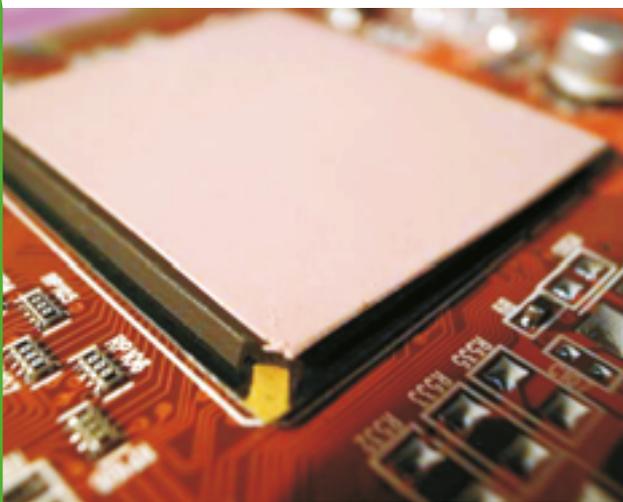




ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ

Теплопроводящие подложки Thermion



Описание

В связи с постоянным ростом производительности и миниатюризацией электронных модулей обеспечение эффективного теплового контакта путем применения соответствующих теплопроводящих электроизоляционных материалов приобретает все большую значимость. Теплопроводящие подложки Thermion – это современное технологичное решение для эффективного отвода тепла от электронных компонентов и устройств с поверхности печатного узла. Теплопроводящие подложки представляют собой рулоны или листы из предварительно полимеризованного силиконового геля или эластомера с наполнителем, обеспечивающим заданную теплопроводность. Благодаря своим свойствам подложки плотно прилегают к поверхности, максимально повторяя ее форму, что позволяет обеспечить высокую эффективность теплопередачи.

Особенности применения и свойства

- Простота в применении – теплопроводящие подложки Thermion не требуют дополнительного нагрева или отверждения. При необходимости материал удаляется легко и без остатков. Не растекается по поверхности.
- Сохранение физических и электрических свойств в широком диапазоне температур и влажности, хорошая химическая стойкость.
- Высокая эластичность и сжимаемость – благодаря этому обеспечиваются качественное заполнение зазоров и высокая эффективность теплопередачи.
- Широкая номенклатура – различные варианты толщин, размеров, теплопроводности, плотности, твердости и клейкости позволяют подобрать оптимальное решение.
- Высокие адгезивные свойства.

Области применения

- промышленная электроника
- электроника военного и специального назначения
- чипы компьютерной памяти
- светотехника
- телекоммуникационное оборудование
- автомобильная электроника
- силовая электроника
- портативные устройства
- модули памяти
- блоки электропитания и силовых преобразователей

Упаковка

- Стандартная поставка: в рулонах и/или листах
- Индивидуальный заказ – штамповка любых форм и размеров.

Хранение и транспортировка

- Температура транспортировки: от 5°C до 32°C.
- Хранить в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре



будущее
создается

Тел.: (495) 788-44-44
materials@ostec-group.ru

121467, Российская Федерация
г. Москва, ул. Молдавская 5/2



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ

Технические характеристики

Теплопроводящие подложки Thermion	MU-P45	ХК-Р10	ХК-Р15
Цвет	Серый	Розовый / Желтый	Зеленый
Поверхностная клейкость: 1 или 2 стороны	нет	1, армированная	2
Толщина, мм	0,5~3,0	0,25~5,0	0,3~5,0
Теплопроводность, Вт/м*К	4,5	1	1,5
Плотность, г/см ³	3,2	1,82	2,44
Твердость Шор А	45	10	30~40
Температура применения, °С	-50~200	-50~200	-40~160
Предел прочности на разрыв, psi	23	>1000	15
Относительное удлинение при разрыве, %	50	30	130
Диэлектрический пробой, кВ	16	16	15
Удельное электрическое сопротивление, Ом-м	>10 ¹⁴	>10 ¹³	>10 ¹³
Класс горючести по UL	V-0	V-0	V-0
Упаковка	в рулонах 10м x 495 мм	в листах 320 x 320 мм	в листах 320 x 320 мм



Помимо популярных теплопроводящих подложек в широкой линейке материалов представлены подложки с различными свойствами, соответствующие уникальным требованиям:

- Теплопроводность от 1 до 6 Вт/м*К
- Толщина от 0,15 до 5 мм
- Вырубка под типы корпусов приборов (ТОЗ, ТО220, ТО126 и т.д.)
- Со специальными свойствами (армированные, с поверхностной клейкостью, не содержащие силикона)
- Различной формы, в листах и рулонах

Инженеры технической поддержки предоставят консультации на экспертном уровне по свойствам, совместимости и выбору теплопроводящих подложек под конкретные производственные задачи.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



121467, Российская Федерация
Москва, ул. Молдавская 5/2

Тел.: (495) 788-44-44
materials@ostec-group.ru



будущее
создается